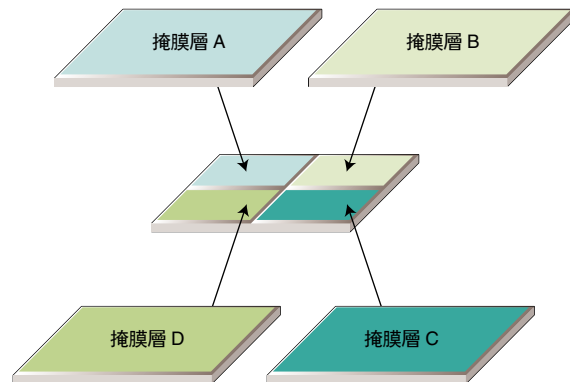


## 新型晶圓原型開發服務 —— “多層掩膜”

多層掩膜 (MLR) 服務能減少掩膜的使用數量，因此能節省初始開發成本並具有靈活的流片時間。MLR 非常適用於那些需要幾百到幾千個工程樣品的晶圓代工客戶。

### 概 要

除了使用整個掩膜組的傳統原型開發服務外，富士通半導體提供“SiExpress”服務能節省原型開發成本和時間。富士通半導體新近推出了“MLR (Multi Layer Reticle)”服務，這是一種介於傳統晶圓原型開發與SiExpress服務之間的中間服務。MLR方法允許具有相同設計的多個掩膜層共用掩膜空間，因此能減少掩膜的使用數量，降低初始工程成本。使用者可隨時流片，而不必像SiExpress那樣擔心時間表。這種新的晶圓原型開發服務非常適合於那些需要幾百到幾千個工程樣片的代工客戶。



### 特 點

MLR 能在 1 個掩膜版上最多建立 4 個同樣規格的掩膜層。MLR 服務所使用的掩膜和晶圓隸屬於單一使用者，而 SiExpress 服務則是多個使用者共用掩膜和晶圓。因此，像傳統的原型開發服務一樣，富士通能隨時接受流片並提供客戶所要求數量的晶圓。在 MLR 服務中，原型產品能以晶圓形式交付；而在 SiExpress 服務中，產品則是以晶片或封裝好的晶片形式交付。

- MLR支援：CS100A\_LL (90nm), CS200L (65nm)
- 晶圓尺寸：12 inch

